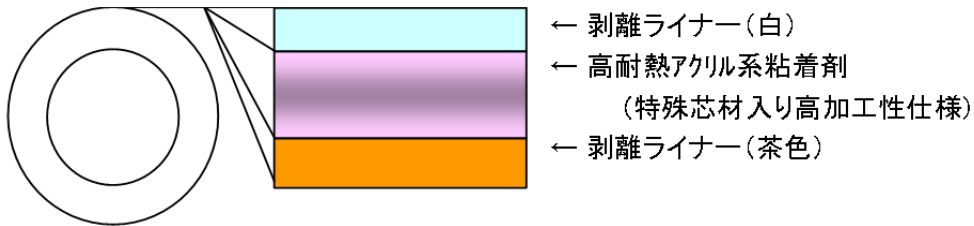


ダブルフェース® R310KS-2

【特徴】

- ・鉛フリーハンダリフロー工程に適応 — 鉛フリーハンダリフロー工程後も優れた粘着力を発揮します。
- ・打ち抜き加工性重視の構成 — 粘着剤の糸引きや加工後の糊戻り・糊飛びが起こりにくい構成です。
- ・あらゆる被着体に対して強粘着力を発揮 — FPC・電子部品等の固定用テープとして使用可能です。

【構成】



【物性】

項目			単位	実測値
粘着テープ厚さ※1			μm	50
剥離ライナー厚さ※2	本セパ（耐熱） 当てセパ			90 130
	対 SUS	20 分 24 時間		N/25 mm
対 PI 24 時間		15. 8		
保持力※4			mm	0. 0
ボールタック※5			—	2 以下
剥離ライナー剥離力※6	本セパ 当てセパ		N/50 mm	0. 35 0. 09
打ち抜き加工性※7			目視	加工性良好

（試験方法）測定雰囲気 23℃50%

- ※1. テープ厚さ: JIS-Z1528(ダイヤルゲージ)
 ※2. 剥離ライナー厚さ:ダイヤルゲージ
 ※3. 粘着力: JIS-Z1528(180℃ピール、300mm/分)テープ背面に PET25μm を貼合 SUS 及びポリイミド(カプトン 100H)と貼合せ測定
 ※4. 保持力: JIS-Z0237(対 SUS、120℃×1 時間、荷重 1kg 重)
 ※5. ボールタック: JIS-Z0237(J.Dow 法、転球角度 30 度)
 ※6. 剥離力:剥離ライナー付きテープと AL 板を貼り合わせ
 2kg ロールで一往復圧着し、剥離紙剥離力を測定(180℃ピール、300mm/分)
 ※7. 加工性:弊社所有打ち抜き加工機を使用(全抜き部端面を目視観察)

【テープ耐熱性】

項目			単位	実測値
リフロー後の 粘着力	対 SUS	未処理	N/25 mm	20.8
		リフロー処理		22.6
	対PI	未処理		16.6
		リフロー処理		17.1

(試験方法)前述基本物性試験方法に準拠

リフロー処理:ANTOM 製 UNI-5016 使用 MAX 温度 260℃

粘着力:テープ背面に3層CCL42μm を貼合し、各被着体に 2 kg ロールで一往復圧着し、圧着の 24 時間後、リフロー処理した試験片を引き剥がし測定した。

上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2025.3 改定